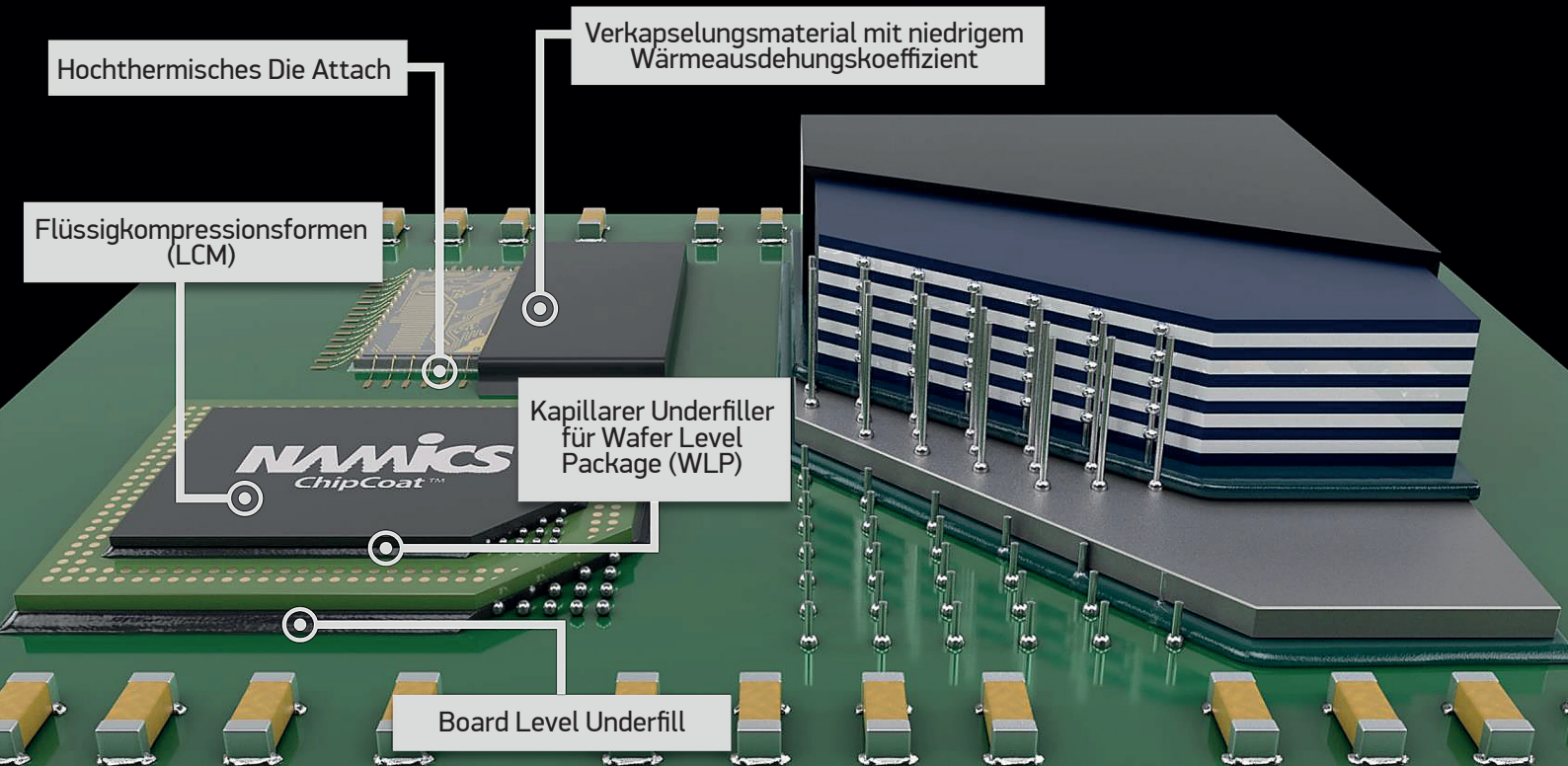


## SYSTEM IN PACKAGING (SIP)



### Geringer Formfaktor, flexibel im Design, niedriger Energieverbrauch

Die Nachfrage nach modernen Halbleitergehäusen basiert heute auf einer heterogenen Integration verschiedener Geräte und Technologien. Ziel ist es, dass die Module der nächsten Generation eine bessere Leistung bei geringerem Stromverbrauch bieten und gleichzeitig die Miniaturisierung vorantreiben. System in Package (SIP) ermöglicht die Integration von Sensoren und verschiedenen Modulen in einem kompakten Gehäuse. Für die SIP-Verpackung werden fortschrittliche Materiallösungen benötigt:

Erhöhung der  
Wärmeableitung

Schutz vor  
RF-Störungen

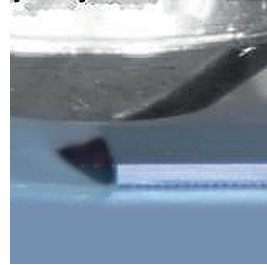
Geringer  
Formfaktor

Hohe Zuverlässigkeit für zukünftige  
Automobilanwendungen

NAMICS bietet eine Reihe innovativer Lösungen, um diese Herausforderungen zu meistern.

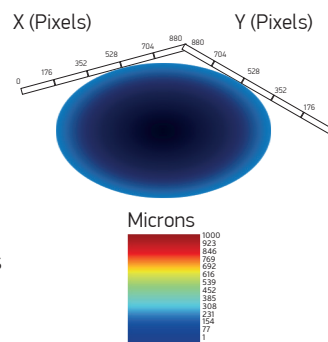
## ■ Kapillarunterfüllung für Wafer Level Package (WLP)

- Optimiertes ultrafeines Füllersystem für lückenloses Füllen von Kupfersäulen mit engen Zwischenräumen
- Minimaler Harzaustritt in der Keep Out Zone (KOZ)
- Formuliert für schnellen Durchsatz und hohe Zuverlässigkeit



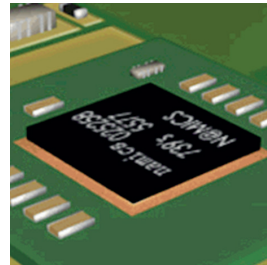
## ■ Flüssigformpressen (LCM)

- Hohe Zuverlässigkeit und minimaler Verzug nach der Aushärtung des Formteils
- Optimiertes Füllersystem für engen Zwischenraum und keine Ablaufspuren
- Hohe Produktivität durch schnellen Aushärtungszyklus
- Kann sowohl auf Wafer- als auch auf Plattenebene verpackt werden



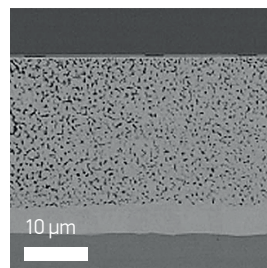
## ■ Board level underfill

- Entwickelt, um die strengen Umwelтанforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen
- Schnell Trocknungssystem mit hohem Durchfluss für die zügige Befüllung großer Formate
- Nacharbeitbar und mit höchster Zuverlässigkeit verfügbar



## ■ Hohe thermische Belastung

- Echte druckfreie Niedertemperatur-Sintertechnologie
- Branchenführende thermische und elektrische Leistung
- Bewährt und bereit für die Herstellung großer Mengen
- Einzigartige Zuverlässigkeit durch harzverstärkte und niedrigmodulige Technologie



## ■ Verkapselungsmaterial mit niedrigem Wärmeausdehnungskoeffizient

- Außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Schutz vor Feuchtigkeit
- Hervorragender Schutz empfindlicher Komponenten
- Einfache Anwendung mit schneller Aushärtung und ausgezeichneter Fließfähigkeit



### Unser Unternehmen

NAMICS ist ein weltweiter Technologieführer in der Fertigung von elektronischen Baugruppen mit mehr als 70 Jahren Erfahrung und Expertise.

Wir bauen mehr als nur Produkte: Wir bauen Beziehungen auf. NAMICS setzt den Goldstandard für Kundenservice, indem wir kundenspezifische Produkte und erstklassigen Kundendienst anbieten, um eine Lösung für Ihre persönliche Anwendung zu finden.

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie NAMICS zu Ihren Zielen beitragen kann.

### Kontakt

Hilpert electronics AG  
Täferstrasse 29  
CH-5405 Baden-Dättwil  
Telefon: +41 56 483 25 25  
Fax: +41 56 483 25 20  
office@hilpert.ch  
www.hilpert.ch

Mehr Informationen unter:

